

深圳秋田微电子股份有限公司

关于向银行等金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。本次申请授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请授信额度概况

为满足公司及公司全资子公司、控股子公司（以下合并简称“子公司”）生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币65,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池、保函、信用证、票据贴现等。授信期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，具体融资方式、融资期限、利率等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。

同时，为提高业务办理效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件。

二、对公司的影响

公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度能有效满足公司日常资金需求，保障生产经营的顺利开展，有利于提高资金使用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2026年04月18日